

江苏亨通光电股份有限公司

关于亨通洛克利受让

ROCKLEY 公司硅光子芯片专利的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 亨通洛克利公司受让洛克利公司三项硅光子芯片设计专利。

2017年12月19日，亨通光电与英国Rockley Photonics Limited(以下简称“洛克利”)签署协议，双方共同出资设立江苏亨通洛克利科技有限公司(以下简称“亨通洛克利”)生产25/100G光子收发器，面向国内、国际两个市场销售；2018年9月，项目完成100Gbps硅光子芯片的首件试制和可靠性测试，完成硅光子芯片测试平台搭建；2019年2月，项目100G光子收发器在美国通过测试；2019年3月，洛克利将100G硅光子芯片技术许可亨通洛克利使用，亨通洛克利形成了100G硅光子芯片设计能力、硅光子芯片制造工艺能力以及硅光子芯片封装能力；同日，亨通洛克利委托洛克利开发400G硅光子芯片及光子收发器，为超100G传输商用做好准备(详见上海证券交易所公告，亨通光电：2017-131号、2018-095号、2019-009、2019-010、2019-011号)。

一、事项概述

鉴于亨通洛克利公司获得洛克利公司100G硅光子芯片技术许可，并委托洛克利开发400G硅光子芯片及光子收发器技术，项目完成后，亨通洛克利享有400G硅光子芯片购买权利，拥有400G DR4光子收发器知识产权及相关利益。亨通洛克利正在建立从100G到超100G，从芯片设计、芯片到光子收发器封装制造的垂直集成能力。

为进一步增强亨通洛克利公司核心竞争力，建立从硅光子芯片设计、芯片封装以及光子收发器封装制造的一体化能力，洛克利公司将其拥有的以下三项硅光子芯片专利技术转让给亨通洛克利公司。

专利号	授权日期	标题
GB2543122	2018-07-18	An optoelectronic component
ZL201580002672.9	2017-09-19	可调谐 SOI 激光器
US9627851	2017-04-18	Discrete wavelength tunable laser

二、对上市公司的影响

公司100Gbps硅光模块已在美国完成性能测试，下一步将在国内搭建测试平台，完成国内测试及产业化工程。在芯片技术许可、专利技术转让、400G芯片及光子收发器技术开发的推动下，亨通洛克利公司将拥有芯片设计关联的知识产权和设计能力，成为硅光子芯片设计、硅光子芯片封装以及硅光模块封装制造为一体的公司，将进一步增强公司核心竞争力，提升公司盈利能力，推动公司可持续增长。

三、风险提示

亨通洛克利受让洛克利公司三项硅光子芯片技术对2019年亨通洛克利公司经营情况和财务状况的影响尚具有不确定性，亨通洛克利公司未来经营发展尚具有不确定性；公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 技术转让协议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一九年三月四日